

御 得 意 様 各 位

第 21 回 半 導 体 ・ セ ン サ パ ッ ケ ー ジ ン グ 技 術 展 出 展 の ご 案 内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 弊社はこのたび「第21回 半導体・センサパッケージング技術展」にて、実績豊富な電子部品用および半導体パッケージングプロセス用表面処理技術に加え、新たな技術および新規製品を多数出展いたします。
 是非ご来場賜り、弊社出展品をご高覧頂きたくご案内申し上げます。

敬具

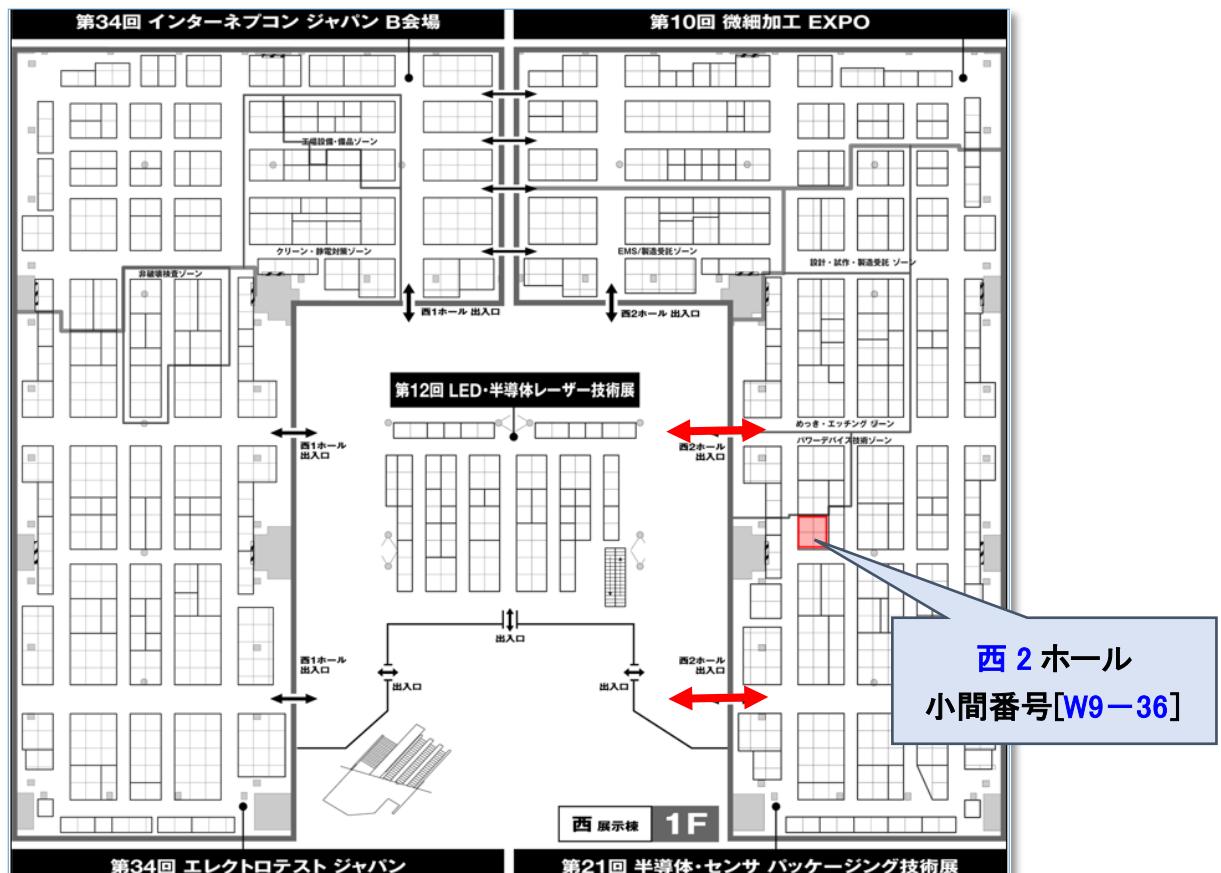
記

日 時：2020年1月15日(水)～1月17日(金)

開場時間：10：00～18：00

※最終日は17：00まで

会 場：東京ビッグサイト：西2ホール・W9-36



【展示品】

高速通信技術を支える微細配線形成に欠かせないエッチング液とレジスト剥離剤、次世代パワーデバイスに対応する無電解めっきプロセス、革新的なアルミニウム合金めっき前処理プロセスなど最新の表面処理薬品プロセスをご紹介します。

□メルプレート UBM プロセス

多くの実績とノウハウを持つメルテックスの無電解 UBM プロセスは、進化し続けています。
特許取得の特殊前処理があらゆるアルミニウム素材の電極ダメージを最小限に抑え、平滑で密着性に優れた UBM 層を形成します。

□シード層エッチング剤・レジスト剥離剤

高い選択性と優れた剥離能力で、更なる極微細配線形成を実現します。
メルテックスのシード層エッチング剤、レジスト剥離剤は、必要な部分をしっかり保護し、不要な部分をスッキリ取り除く基本性能を追求しています。

□コネクタ・リードフレーム用表面処理薬品

過酷な環境下でも高い信頼性の接合を実現するコネクタ、リードフレームの鍵は、表面処理にあります。各種素材に対応したコネクタ、リードフレーム向け表面処理薬品をご紹介します。

□各種金属剥離剤製品

「剥離したい金属は何ですか？」
様々な金属の組み合わせについて、下地を保護し、目的の金属だけが剥離が可能です。メルテックスの豊富な剥離剤ラインナップを是非、ご確認ください。

□易溶性素材向け EN/IG プロセス

New

易溶性素材に対応した中性 pH 域の無電解ニッケル/置換金めっきの新プロセスです。